

证券代码：603061

证券简称：金海通

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	广发基金、光大永明、平安基金、中意资产、中邮基金、中金资管、惠升基金、交银基金、盈京投资（以上排名不分先后）。	
时间	2025年12月1日至12月15日	
地点	公司会议室、腾讯会议等。	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍主要内容</b></p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。</p> <p>公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”</p>	

等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

## 二、公司 2025 年第三季度经营情况介绍

受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年第三季度实现营业收入 1.74 亿元，较上年同期增长 137.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,897.57 万元，较上年同期增长 832.58%；公司 2025 年前三季度实现营业收入 4.82 亿元，较上年同期增长 87.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，较上年同期增长 178.18%。截至 2025 年 9 月末，公司总资产为 19.56 亿元，较上年末增长 22.38%；截至 2025 年 9 月末，公司净资产为 15.39 亿元，较上年末增长 16.94%。

产品方面，2025 年第三季度，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。

公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力，深化客户服务。2025 年前三季度，公司积极拓展新客户，持续深化既有客户合作关系，全面强化客户服务能力建设，公司“马来西亚生产运营中心”的启用助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。

## 三、调研问答

1、问：本期业绩增长的主要原因？

答：受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年第三季度实现营业收入 1.74 亿元，较上年同期增长

	<p>137.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,897.57 万元，较上年同期增长 832.58%。</p> <p>2、问：国际市场拓展方面，公司有什么布局？</p> <p>答：在积极开拓境内市场的同时，公司重点跟进境外头部 IDM、OSAT 以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求。公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。</p> <p>3、问：公司产品未来升级迭代的方向？</p> <p>答：公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。</p> <p>4、问：公司后续有什么计划进一步提升净利润水平？</p> <p>答：公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势。与此同时，公司将不断提升内部运营效率，通过优化生产流程、加强供应链管理、合理控制费用支出等方式，在确保产品质量和技术竞争力的前提下，努力降低生产成本，提高盈利水平。</p> <p>5、问：使用先进封装技术的芯片使用公司设备进行分选的情况如何？</p> <p>答：公司产品集成电路测试分选机主要适用于 QFN（四边扁平无引脚封装），QFP（方型扁平式封装），BGA（球栅阵列封装），LGA（栅格阵列封装），PLCC（塑料有引线片式载体封装），PGA（插针网格阵列封装），CSP（芯片级尺寸封装），TSOP（薄型小尺寸封装）等封装形式的芯片。</p> <p>3D 先进封装是指半导体芯片封装过程中使用的一种先进封装工艺</p>
--	---

技术，在多种半导体产品的封装过程中都可应用。公司产品测试分选机，是在半导体产品设计验证环节和成品检测环节，配合测试机对芯片封装后的成品进行测试分选。据公司了解，使用 2.5D、3D 封装技术的芯片，其成品多表现为 BGA、LGA、PGA 等封装形式，可以使用公司的设备进行成品测试分选。

公司产品集成电路测试分选机在客户公司（半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业、芯片设计公司等）所分选的芯片涵盖汽车电子、消费电子、智能互联、5G 等领域中应用的芯片。公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为。

#### 6、问：行业未来的发展前景？

答：未来，集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工，为确保产品质量、生产效率和生产稳定性，半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发，产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性对分选机设备提出更高要求，测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。

金海通自 2012 年成立以来，一直深耕集成电路测试分选机领域，公司产品技术指标已达到同类产品的国际先进水平。公司将继续保持以技术为核心的策略，进一步扩大现有市场，依靠自身技术优势，针对客户的测试分选需求，提供更优质的服务，获得新的发展。

#### 7、问：请公司更新下对外投资的近况？

答：公司在继续加大技术开发和自主创新力度的同时，也通过对外投资方式积极布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了 5 家公司：

（1）半导体晶圆级分选封测和平板级封装贴晶机设备及方案提供商——深圳市华芯智能装备有限公司，公司主要产品为晶圆级分选机 Wafer to tape&reel（晶圆到卷带）、IGBT KGD（已知良好芯片）分选机；

（2）光通信和半导体设备提供商——苏州猎奇智能设备股份有限公司，公司主要产品为固晶机、耦合设备、测试设备等光通信和半导体设备；

	<p>(3) 芯片动态老化测试设备以及解决方案的提供商——芯诣电子科技(苏州)有限公司, 公司主要产品为动态逻辑老化测试一体机、PXI板卡及小型化仪表等动态老化测试设备;</p> <p>(4) 芯片贴片机及相关服务提供商——鑫益邦半导体(江苏)有限公司, 公司主要产品为超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机;</p> <p>(5) 射频测试仪器、射频测试机及板卡、云平台提供商——瑞玛思特(深圳)科技有限公司, 公司主要产品为射频测试仪器、射频测试机及板卡及相关云平台。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容, 不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺, 不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺, 敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025年12月16日